

超音波半田による ターゲット材料接合技術

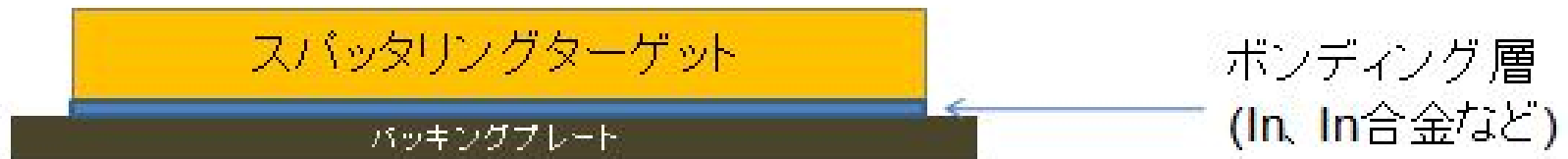
2016. 01. 28 (ver. 03)

【概要】

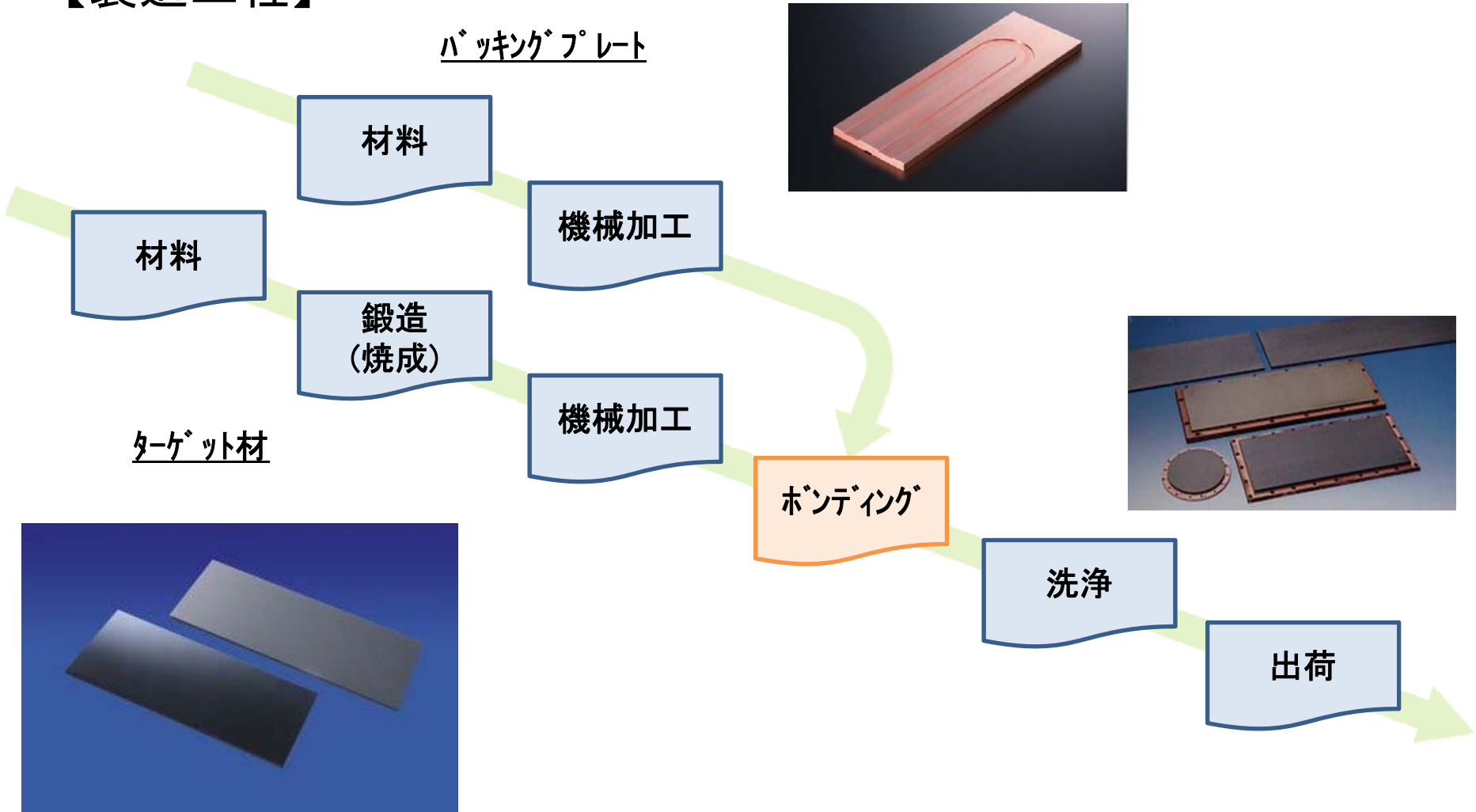
ディスプレイやタッチパネル・太陽電池等の薄膜を形成する技術として、スパッタリングがあるが、スパッタリングターゲットの製造を超音波による接合が可能。

【構造】

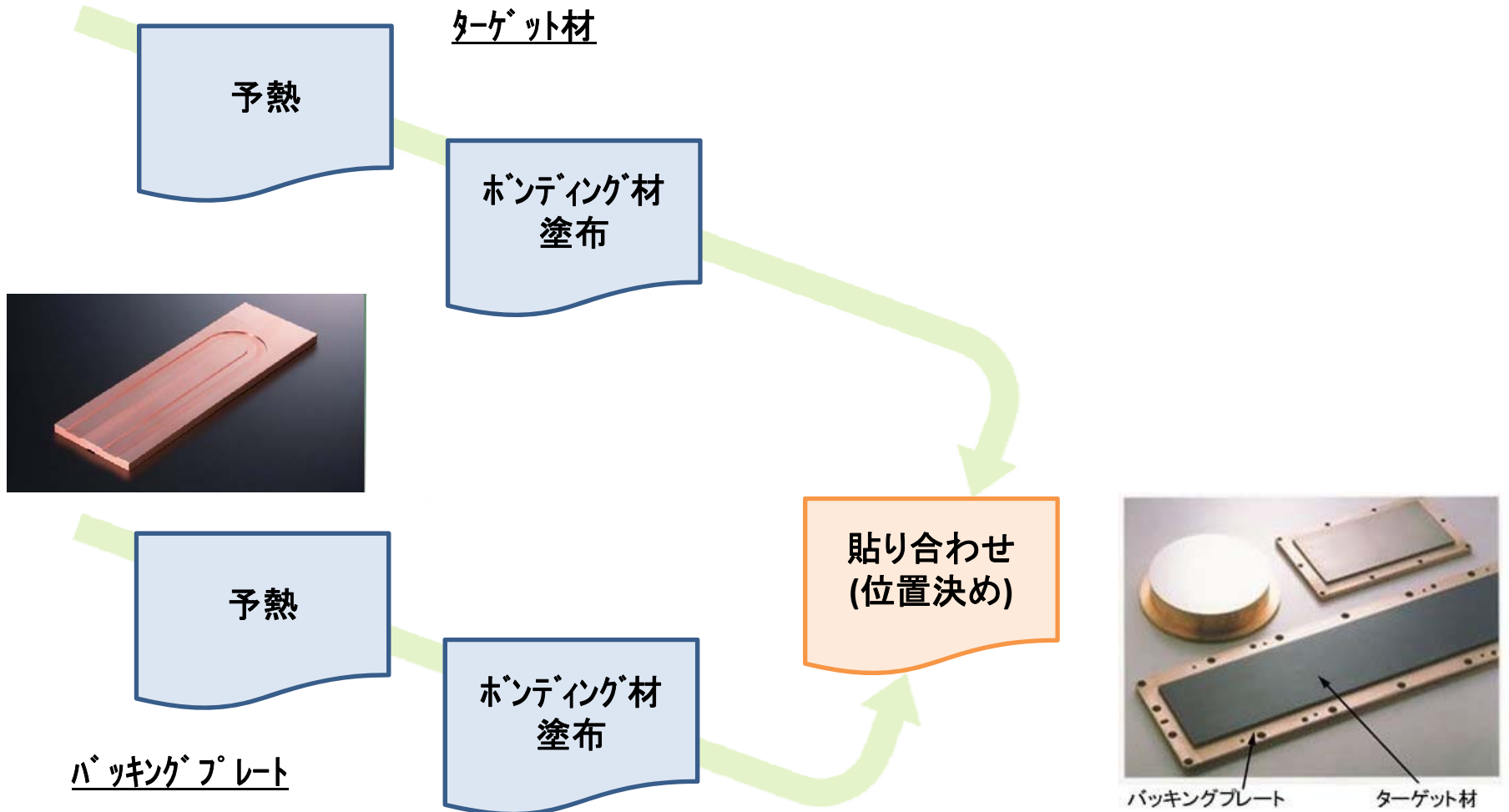
薄膜するターゲット材とバックングプレートをインジウムやインジウム合金で接合（ボンディング）している。



【製造工程】



【超音波によるボンディング工程】



【メリット】

- ・ 下地処理不要
→ 殆どのターゲット材へボンディング可能
- ・ ボンディング材を選ばない
→ インジウムやインジウム合金の他ハンダでも塗布可能
- ・ 接合強度が強い
→ キャビテーションにより強固に接合
- ・ ボンディング材料の無駄削減
→ 最小限のボンディング材で塗布可能

ありがとうございました。



お問合せ

株式会社リソー技研

東京事業所 東京都中央区銀座8丁目18-3-加藤ビル5F
〒104-0061 TEL (03)-6228-4153